



联络人

投资人关系

+886 3397 5999 ext. 1204 / 1202

ir@winfoundry.com

## 稳懋半导体公告 2021 年第三季自结财务报告

---

2021 年 10 月 28 日

稳懋半导体，全球最大砷化镓晶圆代工服务公司，已于今(28)日公告 2021 年第三季自结财务报告。

### 2021 年第三季财务概况

- ◆ 本季合并营收新台币 67.61 亿元，较前季增加 9%，较去年同期增加 3%
- ◆ 本季合并毛利率为 38.8%，较前季增加 3.1 个百分点；本季营业净利率为 26.8%，较前季增加 4.1 个百分点
- ◆ 本季营业净利为新台币 18.1 亿元，较前季增加 28%，较去年同期减少 16%
- ◆ 本季税后净利为新台币 14.96 亿元，较前季增加 61%，较去年同期减少 24%；每股盈余为新台币 3.67 元，前季为新台币 2.32 元

### 2021 年第四季展望

下列对于未来展望的表述是基于对现况的预期，但同时受限于已知或未知风险或不确定性的影响。请参阅后附之「免责声明」。

- ◆ 第四季营收预计较前一季增加 mid-single digit 百分比。
- ◆ 第四季毛利率预计约为 high-thirties 的水平。

---

### 免责声明

本数据可能包含对于未来展望的表述。该类表述是基于对现况的预期，但同时受限于已知或未知风险或不确定性的影响。因此实际结果将可能明显不同于表述内容。除法令要求外，公司并无义务因应新信息的产生或未来事件的发生主动更新对未来展望的表述。

## 管理者评论

“2021年第三季稳懋在客户需求的带动下，合并营收新台币67.61亿元，较前一季成长9%，大致与我们之前的预估相当。在产品组合及产能利用率的双重因素影响之下，使得毛利率优于我们之前的预期，季增3.1个百分点，来到38.8%的今年高点，营业净利率也季增4.1个百分点，来到26.8%的水平。第三季EPS为新台币3.67元，累积前三季EPS为新台币8.71元。

第三季为传统智能型手机旺季，细看产品组合的个别表现，受惠于高阶手机发表效应，以3D感测为主的光学相关产品之营收季成长幅度最大。新一代3D感测芯片的微缩设计，虽然会影响晶圆的的需求总量，但同时也加大了晶圆生产技术的难度及同业的进入障碍，使得稳懋第三季的光学晶圆需求一如往年的强劲不受微缩影响。另外，5G cellular PA及基础建设相关营收均较上一季有个位数百分比的成长。整体而言，cellular PA客户仍是今年成长最为突出的族群，其中5G在第三季仍维持两成以上的比例，与上一季相当，意味着5G手机动能不坠。虽然今年并无新增产能，我们采提升效率将现有产能发挥到极致以充分满足客户需求的策略，纵使第三季产能利用率已高达95%，仍然按部就班的执行既定扩充计划，为明年的新产能开出及未来更长远的扩厂做好准备。

展望2021第四季，我们预期营收将较上一季成长mid-single digit百分比，预计毛利率约为high-thirties的水平。”

---

## 关于稳懋半导体

稳懋半导体成立于 1999 年，位于林口华亚科技园区，是全球首座以六英寸晶圆生产砷化镓微波集成电路(GaAs MMIC)的专业晶圆代工服务公司。稳懋拥有完整的技术团队及最先进的砷化镓微波晶体管及集成电路制造技术及生产设备，客户群除了全球射频集成电路设计公司(RFIC Design Houses)外，并致力吸引与全球整合组件制造(IDM)大厂合作。在制程技术发展方面，稳懋以多元化及领先为原则，期能提供客户最完整的服务。在无线宽带通讯的微波高科技领域中，稳懋目前提供两大类砷化镓晶体管制程技术：异质界面双极性晶体管(HBT)和应变式异质界面高迁移率晶体管(pHEMT)，二者均为最尖端的制程技术。在光通讯及 3D 感测领域中，稳懋更以 MMIC 生产技术为基础，提供光电产品的开发与生产制造。